LAGENAUFBAU HDI (Standard)

HDI10_3+4b+3_1,40_35

10 - Lagen

Kern: 0,51 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:

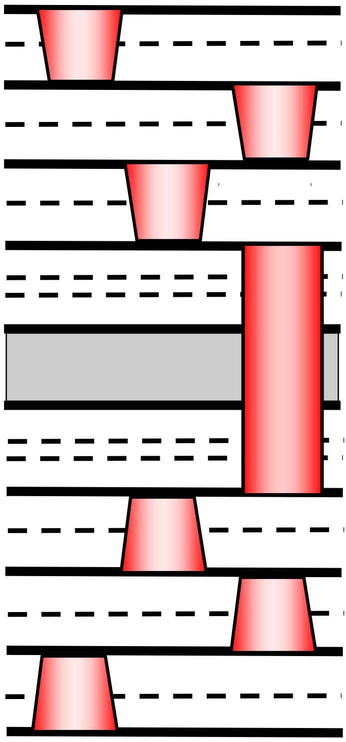
3 + 4B + 3

KUNDE:

WÜRTH ELEKTRONIK

vorl. nur CBT Schopfheim

AUFBAU



LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS	Folie	12 µm	1)	12	
				1 x 1080	60	
2	VSK3	Folie	12 µm		30	
				1 x 1080	60	
3	VSK2	Folie	12 µm		30	
				1 x 1080	60	
4	VSK1		12 µm		35	
				2 x 1080	133	
5	2		35 µm		33	
		0,510 mm			510	
6	3		35 µm		33	
				2 x 1080	133	
7	RSK1		12 µm	1)	35	
				1 x 1080	60	
8	RSK2		12 µm		30	
				1 x 1080	60	
9	RSK3	Folie	12 µm		30	
				1 x 1080	60	
10	BOT/RS	Folie	12 µm	1)	12	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material: 1416

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

					Datum:	Bearbeiter:
MATERIALDICKE:	**1,40**	+/-	0,12	mm		
DICKE über galv. Endoberfläche	1,49	+/-	0,15	mm		
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,55	+/-	0,17	mm		
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:	

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
28.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R.Schönholz	00	22-